

ACP 158 各向异性导电胶产品技术数据表

卓越的热循环可靠性

优异的电导性能

高良率

简介

ACP 158 是一种各向异性导电胶，适用于芯片级封装、球栅阵列封装、叠层封装、焊盘栅阵列、以及部分倒装芯片、应用。该材料同样适用于多种先进封装形式中的裸芯片保护，例如存储卡、芯片载体、混合电路及多芯片模块等。ACP 158 专为高产能、环保型制造环境而设计，兼顾制程速度与可靠性需求。材料易于点胶，可有效降低内应力，提供卓越的可靠性表现(如温度循环性能)以及优异的机械强度。在完成热压键合并固化后，ACP 158 形成的互连结构可达到与传统焊点相当的可靠性水平，为高密度互连及器件微型化提供可靠解决方案。

物理特性

产品名称	ACP 158 导电胶
未固化材料性能	
專案	數值
比重 (ASTM D 1475-60)	1.8 – 2.2 g/cc
粘度(Brookfield, 0.5 rpm)	5 – 8.0 kcP
固化后材料性能	
玻璃化转变温度 (Tg) Via TMA (ASTM D3418-82)	149 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 30$; $\alpha_2 = 135$
剪切强度(FR4/FR4)	2600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	合格

推荐固化条件

在线固化, 或 150 °C × 5–10 分钟

注:5–10 分钟的固化时间包含胶层达到目标固化温度所需的升温时间。可根据实际工艺需求评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 –40 °C 条件下、并保持原始密封包装保存时, 材料的保质期为 6 个月。超过该期限储存, 材料粘度可能会升高。请注意防止受潮、挥发以及异物污染, 否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

ACP 158 为环保型、无毒材料。但在使用和操作过程中, 仍建议遵循一般工业卫生规范。有关详细的安全与操作信息, 请参阅本产品的 安全数据表。

包装规格

ACP 158 毛细管底部填充系列产品提供 10cc 和 30cc 两种规格。其他包装规格可依客户需求提供。如需订购信息, 请联系 YINCAE 公司。